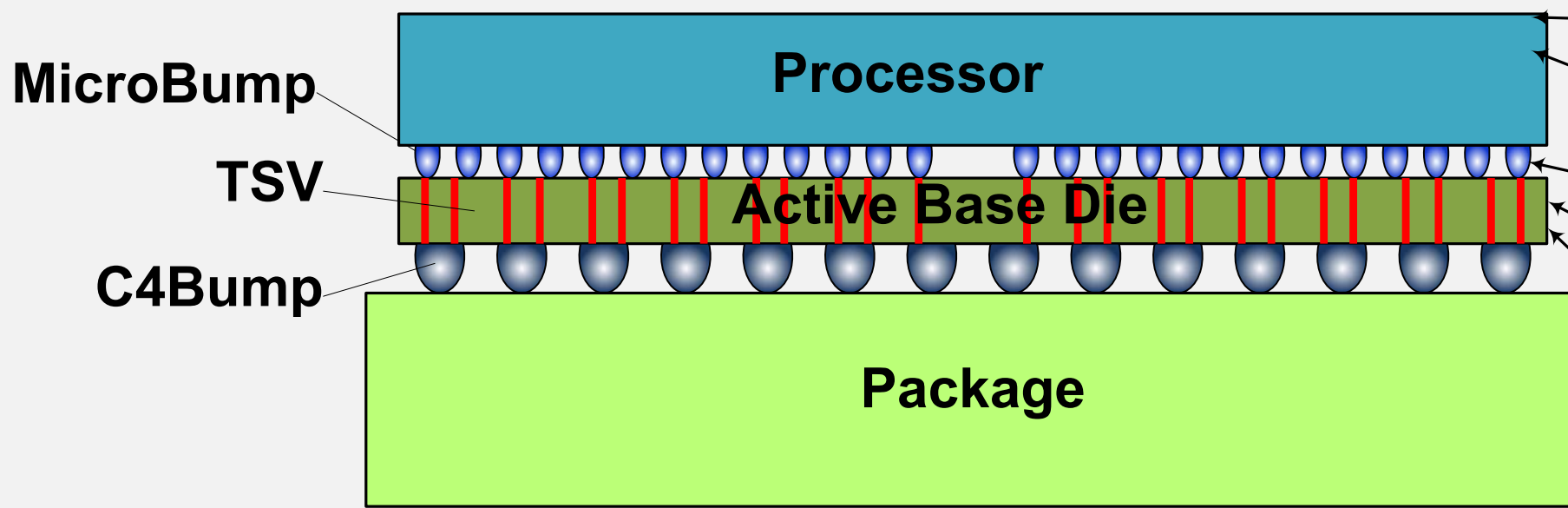


# Intel 3D Foveros

## 3D Foveros



スタックしたダイの熱を狭い面積から排熱しなければならぬため、性能が制約される

トップダイのプロセッサなどにはTSVが不要であるため、コストを抑えられる

チップ間を広帯域&低電力にダイレクト接続

ベースダイのインタポーザをアクティブダイとして様々な機能を入れ込む

信号品質が問題になる機能はボトムダイに配置してTSV経路を避ける

メモリは別ソリューションで統合する必要がある